

# 국제금형 및 관련기기전, 국제전자회로 및 실장전 열려

국내 정밀·광학기기 전시회 이모저모

지난 3, 4월에는 국제금형 및 관련기기전, 부품소재 산업전, 국제전자회로 및 실장전, 광학전시회 등 다양한 정밀·광학기기 전시회가 열렸다. 그중에서도 본고에서는 새롭게 산업기기 분야에 진출한 캐논코리아비즈니스솔루션과 캐리마가 참가한 국제금형 및 관련기기전과 이오테크닉스가 참가한 국제전자회로 및 실장전에 다녀왔다.

|취재/박자연 기자|

## 제19회 국제금형 및 관련기기전 열려 캐논코리아비즈니스솔루션·캐리마, 산업기기 시장 진출

세계 금형산업의 흐름을 한자리에서 볼 수 있는 제19회 국제금형 및 관련기기 전시회(INTERMOLD KOREA 2009)가 지난 3월 18일부터 22일까지 경기 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 단시간의 일정으로 개최됐다.

이번 행사는 일본, 독일, 미국을 비롯해 국내외 19개국 320개 업체가 초정밀 금형과 관련기기를 들고 참여하여 세계 금형산업의 흐름을 한눈에 살펴볼 수 있는 기회를 제공했다. 세계 경기 침체에도 불구하고, 참가규모는 지난 2007년(20개국 340개사)과 비슷한 수준을 유지해 여타 전시회와 달리 산업에 대한 높은 관심을 반영했다는 평을 얻었다.

수출 증진을 위해 3월 19일 한국금형공업협동조합은

KOTRA와 함께 실수요가 높은 일본 바이어 50개사를 초청, 금형 및 부품 수출상담회를 개최했다. 이 자리에는 일본 샤프, 아오야마 몰드 등이 참가해 대일 무역수



▶캐논의 박성용 부정이 사출성형기에 대해 설명하고 있다.

▶광조형기를 전시한 캐리마 부스

지 개선에 일조하고 있는 우리 금형을 널리 알리는 시간을 마련했다. 금형산업은 지난 1998년 처음으로 대일 무역수지 흑자 기조를 달성한 데 이어 지난해까지 꾸준히 일본에 대한 수출액을 늘려왔다.

이번 전시회에서는 캐논코리아비즈니스솔루션(대표·김천주)이 소형 사출 성형기(모델명: LS300·300i)을 선보이고 산업기기 분야로의 진출을 선언했다.

캐논 S&S 영업부의 박성용 부장은 “반도체·의료기기 등 정밀제어 분야 핵심 역량을 갖추고 있어 정밀부품을 생산하는 사출 성형기 분야로 확장이 쉽고, 특히 이 시장이 틈새 분야로 유망해 사업 참여를 결정했다”고 말했다.

캐논 제품은 전동 모터 방식의 초소형 제품으로 필요 할 때 원하는 양만큼 부품을 생산할 수 있고, 금형 제작 기간도 기존 사출기에 비해 3분의 1수준으로 줄였다. 이 때문에 제품 수명이 짧고 시장 변화가 심한 상황에서 바로 대응할 수 있다. 또 기존 소형 사출성형기는 무게가 2~3톤에 달하고 점유 면적도 크지만, 캐논 제품은 240kg에 수직형 타입으로 이동성이 뛰어나며 설치 공간도 크게 차지하지 않는다.

캐논은 가전제품·자동차 부품·휴대폰 등에 들어가는 플라스틱을 생산하는 소형부품업체, 개발과 생산 연구 목적의 대학과 기업 연구소 등을 집중 공략할 방침이다.

사진현상 및 출력기기 전문업체로 잘 알려진 캐리마(대표·이병극) 역시 금형·설계 및 시제품 제작에 활용 되는 괘속 광조형기를 선보이며 산업기기 분야로 본격 진출을 선언했다.

꽤효 광조형기(모델명: my RP2020)는 컴퓨터에 저장된 3차원 형상모델의 기하학적 자료로부터 그 물리적인 모형형상을 신속하게 조형해내는 기기이다. 전 산업에 걸쳐 제조업체들이 제품 생산 전에는 금형 및 설계, 시제품을 제작하게 되는데 이에 따라 시간과 비용, 작업의 불편함 등이 수반됐었다. 그러나 캐리마의 광조형기는 저렴한 가격으로 빠른 시간 안에 최고의 정밀도를 자랑 하는 시제품을 얻을 수 있다.

캐리마의 이병극 사장은 “금번에 개발한 괘속 광조형기는 주어진 설계 제품의 수학적 모델을 그 이전에 존재했던 그 어떤 가공방식과도 비교할 수 없을 만큼 빠른 시간 내에 물리적인 모형으로 재현해 내는 것이 특징”이라고 설명했다.

## 2009 국제전자회로 및 실장전 열려 이오테크닉스, 신개념 레이저 마커 소개

지난 3월 22일부터 나흘간 열린 2009 국제전자회로



▶3월 18일 일산 킨텍스에서 있었던 제19회 국제금형 및 관련기기전(인터몰드 코리아 2009) 개막식 테이프커팅식 광경



▶이오테크닉스는 국제전자회로·실장전에서 신개념 레이저 마커를 공개해 주목을 끌었다.

및 실장전에서 한국기업들의 친환경, 미래형 기술들이 눈길을 사로잡았다. 특히 일반 PCB제조뿐만 아니라 설비, 장비 등 전후방 산업과 연계된 다양한 신제품과 신기술이 공개되면서, 해외 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

이오테크닉스(대표·성규동)는 신개념 레이저 마커를 공개해 주목을 끌었다. 사용자의 요구사항에 맞는 정확한 크기의 글자를 마킹할 수 있고 줄의 너비는 최소 40마이크로미터부터 최대 200마이크로미터까지 조정이 가능해 범용성을 높였다. 이 장비는 빠른 레이저 필스가 반복되기 때문에 시안성이 뛰어나며, 표면 침투력은 25마이크로미터 이하로 안전성도 한층 높였다. 특히 수지, 애피시, 세라믹과 같은 통합 기판 패키지 및 핸드폰용 키패드 등과 같은 일반 범용제품 마킹에도 효과를 볼 수 있다.

한 대 또는 두 대의 레이저로 4~8개의 레이저빔을 뽑아낼 수 있어 기존 방식보다 최대 4배의 효과를 얻을 수 있다. 또한 초당 최대 4000자를 마킹할 수 있어 기존의 마킹기 보다 속도가 최대 8배나 빠른 것이 가장 큰 특징이다.